

ひとわざ(一技)名: 半導体加工装置を使用した研削、切削加工

1. 概要(200字目安)

シリコンウェハをはじめ、金属、セラミック、ガラエポ、ガラス等の難切削材料の切断、研削等の受託が可能です。

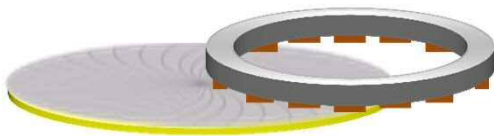
特に、加工精度においては、 $\pm 3\mu\text{m}$ と高精度の加工が可能です。

また、低コスト、短納期で対応いたします。

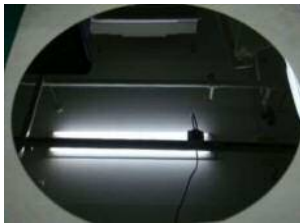
加工後の製品は、トレイ詰めや、真空梱包等、柔軟に対応いたします。

写真・図(要点説明)

バックグラインド(研削加工)

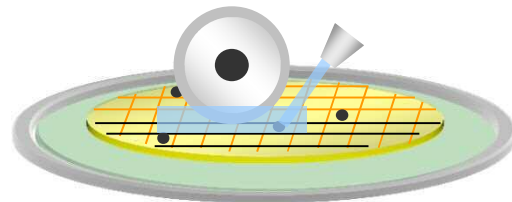


製品を砥石によって研削します。  
また、ポリッシュ装置も保有していますので、鏡面仕上げが可能です。(おもにシリコン)

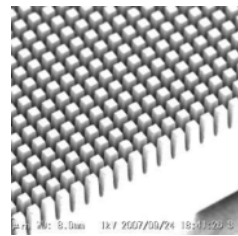


鏡面仕上げ

ダイシング(切削加工)



製品をダイヤモンドブレードによって切り分けます。溝入れ加工も可能です。



シリコン基板の  
溝入れ加工(30μm幅)

2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ ニチワウキョウ	フリガナ	テラサワ シゲル
会社名	株式会社 ニチワ工業	代表者名	寺澤 茂
		フリガナ 窓口担当	サウ ツム 佐藤 努
事業内容	半導体、難切削材の研削、切削加工	U R L	<a href="http://www.nichiwak.co.jp">http://www.nichiwak.co.jp</a>
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造		
フリガナ	ナガノチノシ ホンマチカシ		
住所	〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17		
電話/FAX	0266-72-4069	E-mail	<a href="mailto:info.ic@nichiwak.co.jp">info.ic@nichiwak.co.jp</a>
資本金(百万円)	15	設立年月日	1970/3/1
		売上(百万円)	-
		従業員数	120

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

①・ISO9001:2000年取得済み

・ISO14001:2003年取得済み

②半導体用の高精度設備を多数そろえておりますので、上記加工だけでなく、各種トレイ詰め、仕様に応じた梱包状態で出荷が可能です。また、超純水製造設備を所有しておりますので、洗浄作業等も可能です。